



8412 ACF



제품 정보

45µm 황색 이방성 전도성 HAF 테이프

제품 설명

tesa® HAF 8412는 전도성 입자가 함유된 니트릴 고무와 페놀 수지로 된 열활성 양면 황색 점착 필름입니다.

특성:

- 한 번의 작업으로 안정적인 칩 점착력과 전기적 연결성을 유지함
- 일반적인 삽입 공정에서의 우수한 작업성
- PVC, ABS, PET, 폴리카보네이트 카드(DI)에 적합
- 우수한 내후성

두께: 45µm (입자 크기의 중간값)

특성

- Excellent grounding performance in applications with structural bonding requirements
- High bonding strength in narrow and small bonding areas
- Good ageing resistance
- Reliable SmartCard chip bonding and electrical connectivity in one step
- Suitable for PVC, ABS and PC SmartCards (DI)

Applications

tesa® HAF 8412는 접착/비접착식 방식으로 듀얼 인터페이스 스마트 카드에 칩 모듈을 삽입하는 용도로 설계된 제품입니다.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|-----------------|-------|-------|
| • 기재 소재 | 없음 | • 총두께 | 50 µm |
| • 점착제 종류 | 니트릴고무 /
페놀수지 | • 컬러 | amber |
| • 이형지 종류 | 글라신지 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|--------------------------|----------|-------|---------------------|
| • Activation temperature | 120 °C | • 점착력 | 4 N/mm ² |
| • z-축 방향 접착저항 (2kg) | 200 mOhm | | |

추가정보

Technical Recommendations:

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=08412>



8412 ACF

제품 정보

추가정보

The following values are recommendation for machine parameters to start with. Please note that optimum parameters strongly depend on the type of machine, particular materials for card bodies and chip-modules as well as customer requirements.

Embedding of chip-modules into dual interface smart cards

1. Pre-lamination:

During pre-lamination, the adhesive tape is laminated onto the module belt. The pre-lamination step does not effect the shelf life time of the adhesive tape. Pre-laminated module belts can be stored over the same period of time as the adhesive tape.

Machine setting: Temperature 130 – 150 °C, Pressure 2 – 3 bar, Speed 1.5 – 2.5 m/min

2. Module embedding

During module embedding, the pre-laminated modules are die-cut from the module belt, positioned into the card cavity and permanently bonded to the card body by heat and pressure. Depending on the type of the implanting line, single step or multiple step process can be used. Today, most implanting machines have multiple heat press steps.

Single step process

Machine setting: Temperature¹ 180 – 220 °C, Pressure 80 – 130 N/module, Time 1.5 s

3. Multiple step process (2 or more heating stamps)

Machine setting: Temperature¹ 180 - 220 °C, Pressure 80 - 130 N/module, Time 2 x 0.7 s / 3 x 0.5 s

¹Temperature recommendations refer to what can be measured inside the heating stamp. Different temperature settings are recommended for different card material:

- PVC 180 – 190 °C
- ABS 180 – 190 °C
- PET 190 – 200 °C
- PC 200 – 220 °C

Grounding applications in consumer electronics

1. Pre-lamination: During pre-lamination, the tape is laminated onto one component.

Machine setting: Temperature¹ ≥120 °C, Pressure² ≥5 bar, Time ≥5 s



8412 ACF

제품 정보

추가정보

2. Bonding: Remove the liner from the tape after pre-lamination step. Place the pre-laminated component onto the substrate to bond with. Apply sufficient temperature while applying pressure for the bonding time to reach sufficient bonding strength.

Machine setting: Temperature² 120-250 °C, Pressure³ 5-30 bar, Time 5 s – 3 min

² 'Pre-lamination' and 'Bonding' temperature refer to the data that is measured in the bond line. ³ 'Pre-lamination' and 'Bonding' pressure refer to the force that is transformed from jig surface directly to the bonding area. Bonding strength values were obtained under standard laboratory conditions. (Material: etched Al test specimen / bonding conditions: temperature = 180 °C; pressure = 10 bar; time = 7 sec). To reach maximum bonding strength surfaces should be clean and dry.

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=08412>